

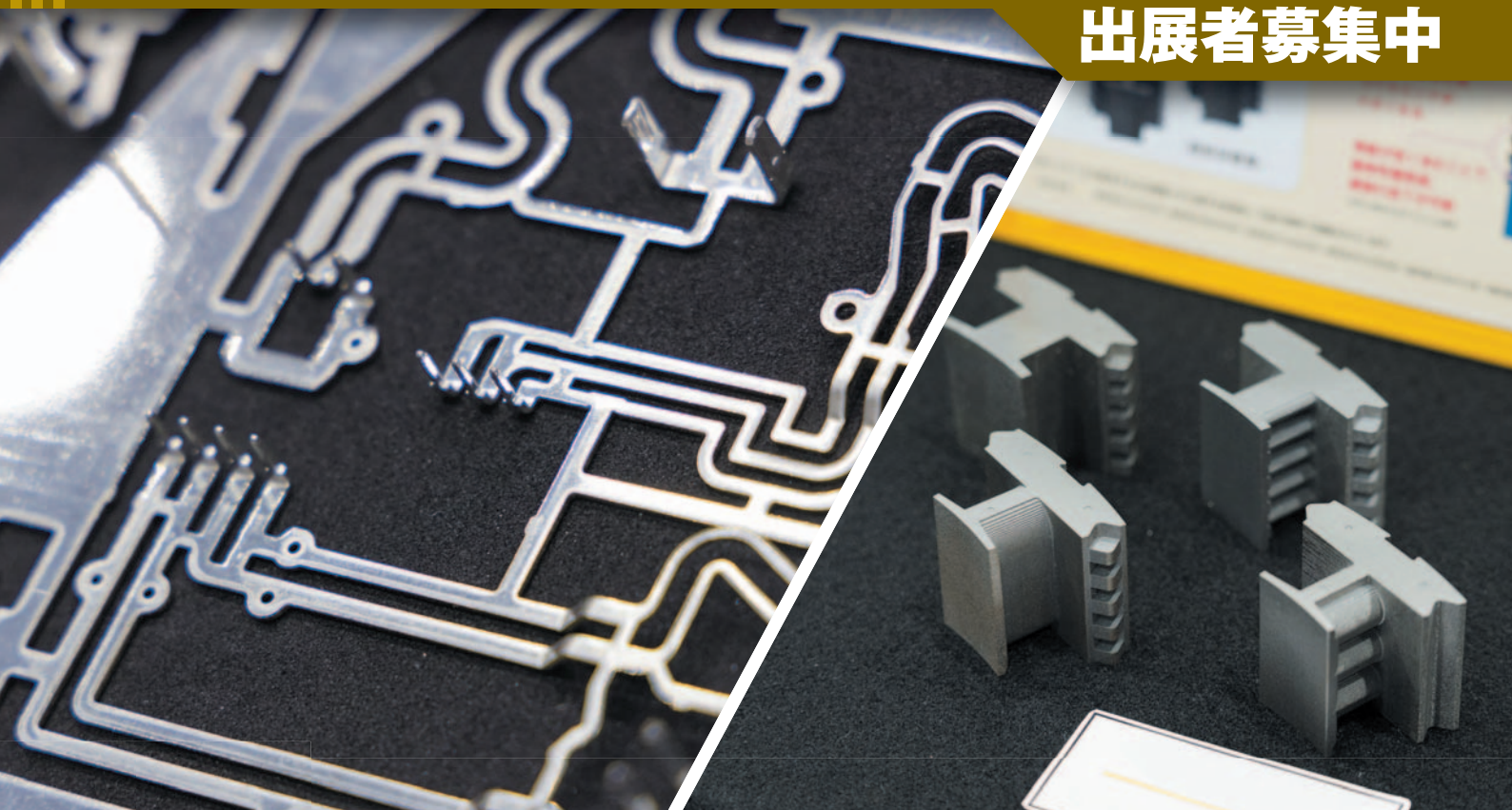
NEW

INTERMOLD 特別出展企画

電子部品製造技術 フェア

2027年
4月14日(水) > 16日(金) 10:00 > 17:00
東京ビッグサイト
〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

出展者募集中



**Point
1**

金型・精密加工技術×電子部品製造案件のマッチングで新規案件獲得を目指す
機器の高性能化に伴い加工精度の向上が求められており、INTERMOLDが得意とする「金型・微細精密加工技術」が市場ニーズに合致しています。

**Point
2**

全来場者のおよそ半数が電子部品製造関連のためマッチング期待値が高い
半導体や家電、通信、医療機器など電子部品製造に関わる来場者が全体の43%。
これからの伸びも期待でき、新規案件獲得の可能性も高まります。

主な出展対象

■精密加工・金型

コネクタ端子/リードフレーム/精密プレス金型、MEMS/センサ部品/
光学部品/微細金型、医療機器部品

■樹脂・複合成形

コネクタハウジング/絶縁部品/高周波対応部材

■放熱・機能部材加工

ヒートシンク/パワー半導体関連構造 など

主な来場対象

■コネクタメーカー

■電子部品メーカー

■半導体パッケージ企業

■EV/車載電装メーカー

■通信機器、産業機器メーカー

■光学・センサメーカー

■医療機器製造メーカー など

お問い合わせ

インターモールド振興会

〒540-0008 大阪市中央区大手前1-1-7

(株) テレビ大阪エクスプロ内

TEL : 06-6944-9911

E-mail : infoim2027@tvoe.co.jp

出展料などの詳細はこちら

